

КИНЕТИКА ДЕГРАДАЦИИ КРАСНЫХ AlGaAs СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

*T. V. Торчинская, B. A. Воротинский, Ж. С. Абдуллаев,
M. K. Шейнкман*

Показано, что процесс деградации красных AlGaAs светодиодов (СД) состоит из двух элементарных процессов: релаксации упругих напряжений в системе на начальном этапе и диффузии атомов Zn из подложки, приводящей к образованию центров рекомбинации в активном слое в процессе долговременной деградации. Установлено, что кинетика процесса долговременной деградации СД хорошо описывается диффузионной моделью. Показано, что процесс релаксации упругих напряжений рекомбинационно-стимулированный, в то время как процесс диффузии атомов Zn из подложки не является рекомбинационно-стимулированным.

Введение

В AlGaAs—GaAs гетероструктурах различают быструю и медленную деградации инжекционной электролюминесценции (ЭЛ) [¹⁻⁴]. Быстрая компонента, как правило, обусловлена релаксацией упругих напряжений в системе [^{3, 4}]. Медленную связывают с образованием в активном слое центров безызлучательной рекомбинации (ЦБР). Последнее может быть следствием рекомбинационно-стимулированной генерации точечных дефектов с последующим объединением их в ЦБР [¹] либо результатом диффузионно-дрейфового перераспределения примесей и собственных дефектов в поле *p*—*n*-перехода [²]. Цель настоящей работы состояла в изучении природы процессов, обуславливающих медленную деградацию красных СД. На основании сопоставления экспериментальной кинетики деградации исследованных СД с результатами теоретических расчетов делаются выводы об элементарных физических механизмах указанных процессов.

Экспериментальные результаты

Исследовались промышленные *n*—*p*—*p*⁺-типа СД на основе Al_{*x*}Ga_{1-*x*}As:Te — (*x* > 0.34)—Al_{0.34}Ga_{0.66}As:Zn—GaAs:Zn гетероструктур, полученные жидкокристаллической эпитаксией [⁵]. Спектр ЭЛ исследованных СД содержал две полосы свечения: красную (К) $\hbar\nu_m = 1.82$ эВ и инфракрасную (ИК) $\hbar\nu_m = 1.39 - 1.40$ эВ, обусловленные излучательной рекомбинацией неравновесных носителей в *p*-Al_{0.34}Ga_{0.66}As слое и в переходном слое у GaAs подложки, вследствие поглощения в последней основной К полосы свечения.

Деградация партий СД, состоящих из 15—25 приборов, происходила при пропускании в прямом направлении тока $J_x = 5 - 50$ А/см² и температуре окружающей среды 70, 85 [⁶] 100 °C в течение 5000 ч. Основные экспериментальные результаты следующие.

1. Изменение мощности излучения P в процессе деградации СД происходит немонотонно (рис. 1). В первые 100—200 ч наблюдается, как правило, снижение P , далее в течение некоторого периода времени t_1 величина P не изменяется, а затем ($t_1 < t < 5000$ ч) вновь начинает снижаться (рис. 1).

2. Длительность периода t_1 зависит от температуры $p-n$ -перехода T_{p-n} и не зависит от тока через диод J_d при одинаковой величине T_{p-n} (рис. 2). Уменьшение t_1 с ростом T_{p-n} происходит по экспоненциальному закону с энергией активации процесса $\epsilon \approx 0.38 \pm 0.05$ эВ.

3. На начальном участке деградации СД происходит рост туннельного, термополевого [6] и рекомбинационного токов (рис. 3, кривые 1—3). При этом

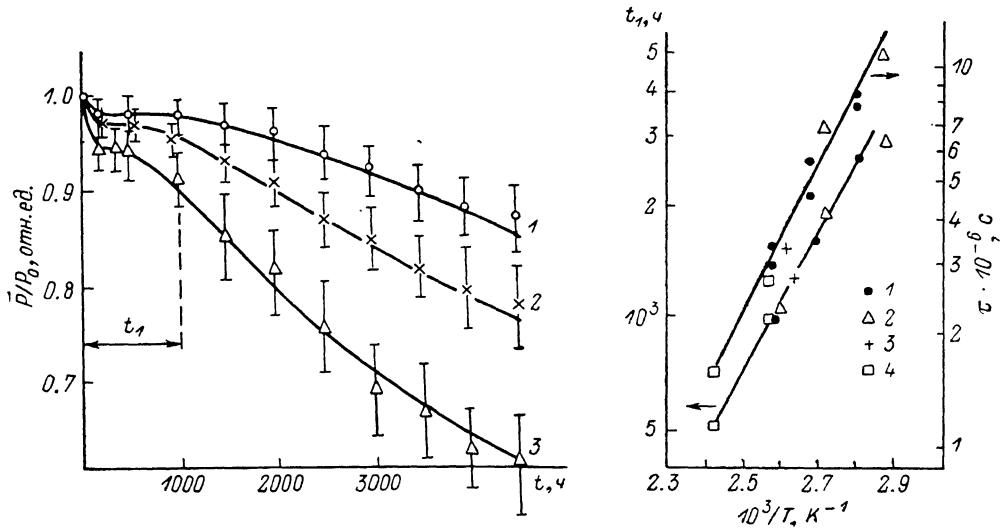


Рис. 1. Относительное изменение средних значений мощности излучения при деградации СД.
Т, К: 1 — 358, 2 — 373, 3 — 388.

Рис. 2. Зависимость экспериментальных значений интервала t_1 и расчетных значений параметра τ от T_{p-n} при различных токах через СД.

1 — 25, 2 — 40, 3 — 12, 4 — 150 мА.

параметр ВАХ возрастает с 1.3 до 1.5. Одновременно более существенно уменьшается интенсивность ИК полосы по сравнению с К полосой [7].

4. В процессе медленной деградации СД (200—4000 ч) ВАХ в области малых токов не изменяется (рис. 3, кривые 3—5), уменьшается величина последовательного сопротивления R_n , а в некоторых СД снижается напряжение пробоя $U_{\text{проб}}$ и растет емкость диодов. При этом температурный коэффициент $U_{\text{проб}}$ не изменяется и равен $5 \cdot 10^{-3}$ В/град. В дальнейшем ($t \approx 5000$ ч) вновь начинает расти избыточный ток (рис. 3, кривые 5, 6).

Анализ экспериментальных результатов

Начальный участок деградации СД мы связываем с рекомбинационно-стимулированной релаксацией упругих напряжений в гетеросистеме. Величина последних, рассчитанная по методике [8], достигает $5 \cdot 10^7$ Н/м². Процесс релаксации напряжений сопровождается одновременным появлением дефектов на гетерограницах $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-\text{Al}_{0.34}\text{Ga}_{0.66}\text{As}$ и $\text{Al}_{0.34}\text{Ga}_{0.66}\text{As}-\text{GaAs}$. Об этом свидетельствуют рост избыточного термополевого тока на ВАХ, который, как правило, связан с протяженными дефектами в (ОПЗ) области пространственного заряда $p-n$ -перехода [6]; более значительное снижение интенсивности ИК полосы по сравнению с уменьшением К полосы, указывающее на падение внутреннего квантового выхода ИК излучения в переходном слое у подложки; увеличение радиуса ¹ кривизны исследованных AlGaAs—GaAs гетероструктур (от 1.43—1.65 до 1.56—1.72 м) после облучения γ -квантами Co^{60} в области малых доз (10^6 Р), моделирующего процесс деградации СД [9].

¹ Радиус кривизны исследованных гетероструктур измерялся рентгеновским методом [10].

Проанализируем теперь причины, вызывающие долговременную (250—4000 ч) деградацию СД. Снижение R_s , а в ряде случаев уменьшение $U_{\text{проб}}$ и рост емкости диодов в этот период свидетельствуют об увеличении в активном p -слое концентрации акцепторов, по-видимому, атомов легирующей примеси Zn. В принципе источником атомов Zn могут быть некоторые комплексы, выделяющие Zn при инжекционно-стимулированном их распаде. Однако, как показали исследования глубоких центров (ГЦ) в данных диодах [11], концентрация обнаруженных ГЦ значительно ниже концентрации мелких акцепторов в p -слое. Поэтому мы полагаем, что рост концентрации акцепторов в p -слое происходит вследствие

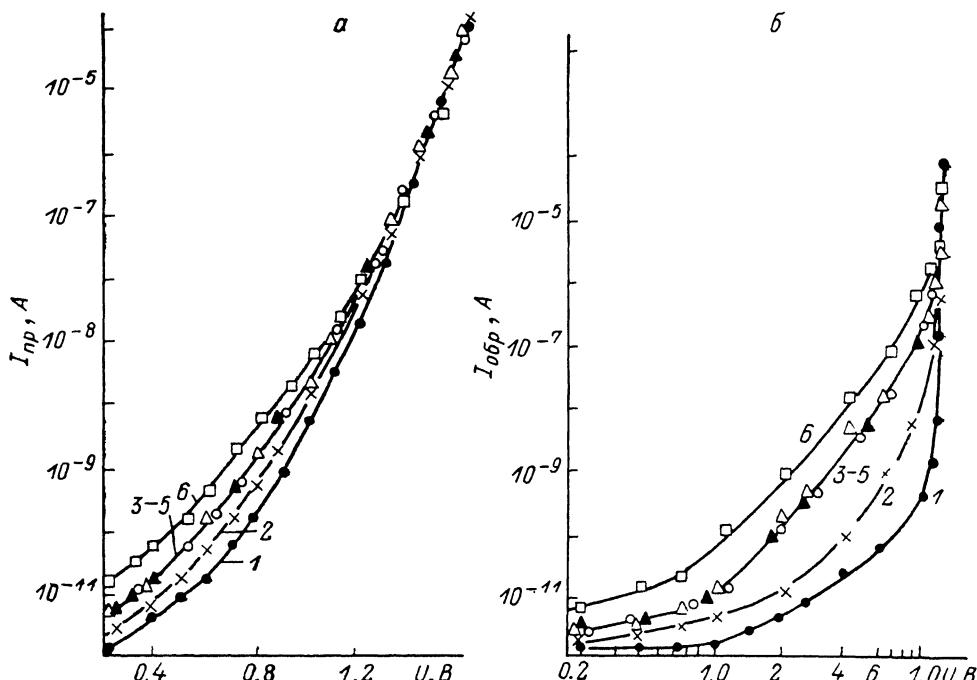


Рис. 3. Прямая (а) и обратная (б) ветви ВАХ СД при 300 К в различные моменты времени деградации.

1 — 0, 2 — 100, 3 — 200, 4 — 1500, 5 — 2000, 6 — 4000 ч.

диффузии атомов Zn из высоколегированной подложки к $p-n$ -переходу. Возрастание концентрации атомов цинка в p -слое приводит к увеличению там числа ЦБР, — по-видимому, комплексов Zn с имеющимися в решетке дефектами, концентрация которых велика. Последнее вызывает снижение мощности излучения СД вследствие уменьшения внутреннего квантового выхода К излучения в активном p -слое $\eta_{\text{вн}}$ [11]. При этом величина тока на прямой и обратной ветвях ВАХ еще не изменяется, т. е. коэффициент инжекции η_j остается постоянным.

В конце исследуемого периода деградации СД (4000—5000 ч) наблюдается опять рост избыточного тока на ВАХ. По-видимому, увеличение концентрации цинка в p -слое вызывает рост скачка напряжения на границе $p-n$ -перехода и его последующую релаксацию.

Модель процесса долговременной деградации СД

Для теоретического описания кинетики накопления ЦБР в активном AlGaAs p -слое используем диффузионную модель деградации СД, предложенную ранее [12] для красных GaP СД. Авторы [12] рассматривали диффузию примеси Zn из p -слоя GaP в область пространственного заряда (ОПЗ) при прямом смещении на $p-n$ -переходе с образованием там ЦБР (так называемый механизм деградации Лонджини [12]).

В отличие от [12] мы будем полагать, что ЦБР возникают в активном *p*-слое при деградации СД вследствие увеличения там концентрации междуузельных атомов Zn_i (N_{Zn_i}), дифундирующих из высоколегированной GaAs подложки. Атомы Zn_i, имеющиеся в *p*-слое до деградации, также образуют ЦБР, но их концентрация со временем не изменяется и учтена в исходной величине времени жизни электронов в *p*-слое τ_0^0 . Концентрацию атомов Zn_i в подложке будем считать постоянной и равной N_0 . Тогда начальные условия нашей задачи можно записать в виде (рис. 4)

$$N_{Zn_i}(x, 0) = \begin{cases} N_0, & x < 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases}$$

а граничные условия для рассмотренного случая следующие: $N_{Zn_i}(0, t) = N_0$ и $N_{Zn_i}(x_p, t) = 0$, где $x_p = d_p - W_p$, d_p — толщина *p*-слоя, а W_p — ширина области пространственного заряда (ОПЗ) (рис. 4).

Рассмотренная задача сводится к задаче диффузии примеси из постоянного источника в полуограниченное тело со связывающей границей [14]. Решение последней известно и имеет вид

$$N_{Zn_i}(x, t) = N_0 \left[\frac{x_0 - x}{x_p} - \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin(m\pi x/x_p)}{m} \exp\left(-\frac{m^2\pi^2 D t}{x_p^2}\right) \right]. \quad (1)$$

Концентрацию ЦБР N_6 , возникающих в активном *p*-слое вследствие диффузии туда атомов Zn_i из подложки, представим как $N_6 = k \int_0^t F_{Zn_i} dt$, где k — некий постоянный коэффициент, а F_{Zn_i} — поток атомов Zn_i. Накопление дефектов будем рассматривать на границе ОПЗ в *p*-слое $x = x_p$. Указанная плоскость выбрана потому, что именно там происходит основная доля рекомбинационных излучательных переходов. Тогда интересующую нас величину N_6 можно рассчитать как

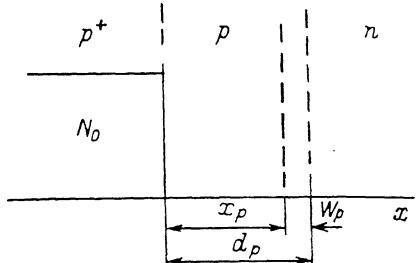


Рис. 4. Рассмотренное в задаче распределение концентрации атомов Zn_i в гетеросистеме.

$$N_6 = k \int_0^t -D \left(\frac{\partial N_{Zn_i}(x, t)}{\partial x} \right) \Big|_{x=x_p} dt, \quad (2)$$

где D — коэффициент диффузии атомов Zn_i в *p*-слое СД.

Подставив выражение (1) в (2), имеем

$$N_6 = k \cdot N_0 x_p \left[\frac{t}{4\tau} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m} \left[1 - \exp\left(-\frac{m^2\pi^2 t}{4\tau}\right) \right] \right], \quad (3)$$

где $\tau = x_p^2/(4D)$ — характеристический параметр процесса.

Анализ кинетики деградации мощности излучения СД

Интенсивность К полосы свечения определяется выражением вида

$$L = \eta_J \cdot J_n \cdot \eta_{\text{вн}} \cdot \eta_0 \cdot S, \quad (4)$$

где $\eta_J = J_e/J_n$ — коэффициент инжекции, J_n — плотность полного тока, S — площадь *p-n*-перехода, $\eta_{\text{вн}}$ — внутренний квантовый выход свечения, η_0 —

коэффициент выхода свечения из материала, J_e — плотность диффузионного тока электронов в p -слое.

В рассматриваемый период долговременной деградации СД (250—4000 ч) величина η_v не изменяется (рис. 3), J_n при измерениях поддерживается постоянным, и, полагая τ_{e0} также неизменным, приходим к выводу о том, что уменьшение интенсивности К полосы обусловлено снижением $\eta_{\text{вн}} = \tau_e / \tau_n$, где τ_n — время жизни электронов по отношению к излучательному захвату.

Относительное изменение в процессе деградации СД $L(t)/L_0$ со временем будет

$$\alpha(t) = \frac{L(t)}{L_0} = \frac{\tau_e}{\tau_{e0}}. \quad (5)$$

Изменение времени жизни электронов в p -слое из-за увеличения концентрации ЦБР можно выразить в виде

$$\frac{1}{\tau_e} = \frac{1}{\tau_{e0}} + v_T \cdot S_6 \cdot N_6(t). \quad (6)$$

Тогда, используя выражение (3) и (4), можно записать

$$\alpha(t) = \frac{L(t)}{L_0} = \left[1 + M \beta \left(\frac{t}{\tau} \right) \right]^{-1}, \quad (7)$$

$$M = A \cdot k \cdot N_0 x_p = \tau_{e0}^0 \cdot v_T \cdot S_6 \cdot k \cdot N_0 x_p, \quad (8)$$

$$\beta \left(\frac{t}{\tau} \right) = \left[\frac{t}{4\tau} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m^2} \left[1 - \exp \left(-\frac{m^2 \pi^2 t}{4\tau} \right) \right] \right]. \quad (9)$$

Учтем изменение $\alpha(t)$ на начальном участке процесса деградации $t \rightarrow 0$, вызванное релаксацией упругих напряжений, введением коэффициента $\alpha_0 = \alpha(t)|_{t=250 \text{ ч}}$. Тогда изменение $\alpha(t)$ в процессе деградации можно представить в виде

$$\alpha(t) = \frac{\alpha_0}{1 + M \left[\frac{t}{4\tau} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m^2} \left[1 - \exp \left(-\frac{m^2 \pi^2 t}{4\tau} \right) \right] \right]}. \quad (10)$$

Экспериментальные кривые кинетики относительного изменения средних значений мощности излучения $\alpha(t)$ в партии СД были обработаны с использованием ЭВМ. В результате получены параметры α_0 , M и τ (см. таблицу), позволившие описать экспериментальные кривые кинетики деградации P с точностью не ниже 4 % (рис. 1).

Из значений $\tau = x_p^2 / 4D$ был рассчитан коэффициент диффузии D подвижных дефектов для $x_p = 20 \text{ мкм}$ (см. таблицу). Изменение последнего с ростом температуры $p-n$ -перехода происходило экспоненциально $D = D_0 \exp(-(E_a/kT))$ с энергией активации процесса $E_a = 0.37 \pm 0.03 \text{ эВ}$ и коэффициентов $D_0 \approx 10^{-7} \text{ см}^2/\text{с}$.

Номер партии	$J_D, \text{ мА}$	$T_{ok}, ^\circ\text{C}$	$T_{p-n}, \text{ K}$	M	$\tau, \text{ с}$	α_0	σ	$D, \text{ см}^2/\text{с}$
1	25	100	388	0.53	$3.0 \cdot 10^6$	0.945	0.055	$1.33 \cdot 10^{-12}$
2	25	100	388	0.49	$3.3 \cdot 10^6$	1.02		$1.21 \cdot 10^{-12}$
3	25	85	373	0.36	$4.4 \cdot 10^6$	0.97	0.03	$9.10 \cdot 10^{-13}$
4	25	85	373	0.39	$5.6 \cdot 10^6$	1.01		$7.15 \cdot 10^{-13}$
5	25	70	358	0.43	$8.1 \cdot 10^6$	0.975	0.025	$4.94 \cdot 10^{-13}$
6	25	70	358	0.42	$7.9 \cdot 10^6$	1.92		$5.05 \cdot 10^{-13}$
7	12	100	380	0.27	$3.1 \cdot 10^6$	0.98	0.02	$1.29 \cdot 10^{-13}$
8	40	70	367	1.5	$7.5 \cdot 10^6$	1.95		$5.33 \cdot 10^{-13}$
9	40	50	347	2.9	$11.4 \cdot 10^6$	0.96	0.04	$3.5 \cdot 10^{-13}$
10	150	50	413	0.57	$1.55 \cdot 10^6$	0.58	0.42	$3.58 \cdot 10^{-12}$
11	150	25	388	0.23	$2.5 \cdot 10^6$	0.60	0.40	$1.6 \cdot 10^{-12}$

Если бы процесс диффузии дефектов был рекомбинационно-стимулированным, то следовало бы ожидать изменения величины D_0 с ростом тока J_d через $p-n$ -переход при деградации. Анализ рис. 2 показывает, что коэффициент диффузии дефектов D зависит только от температуры $p-n$ -перехода. При равенстве последней в партиях СД равны и коэффициенты D и D_0 , несмотря на то что ток через СД мог существенно отличаться. Этот факт свидетельствует в пользу предложенной модели медленной деградации AlGaAs СД, в которой предполагалось, что дефекты диффундируют к $p-n$ -переходу из GaAs подложки, удаленной от области рекомбинации инжектированных носителей.

Параметр M слабо зависит от температуры $p-n$ -перехода и тока через СД. В то же время значение $\sigma = 1 - \alpha_0$, отражающее изменение величины $L(t)/L_0$ вследствие релаксации упругих напряжений в системе незначительно возрастает с ростом T_{p-n} и существенно увеличивается при росте J_d (см. таблицу). Последнее свидетельствует о рекомбинационно-стимулированном характере процесса релаксации упругих напряжений в гетеросистеме.

Выводы

В результате проведенной работы показано, что процесс деградации красных AlGaAs СД представляет собой сложное явление, обусловленное рекомбинационно-стимулированной релаксацией упругих напряжений в гетеросистеме (на начальном участке) и диффузией примеси, по-видимому, атомов Zn из подложки в объем активного слоя. На основании сопоставления экспериментальных и расчетных значений относительного изменения мощности излучения СД при деградации определены коэффициент диффузии примеси и энергия активации процесса. Показано, что процесс диффузии не является рекомбинационно-стимулированным.

Список литературы

- [1] Gold R. D., Weisberg L. R. // Sol. St. Electr. 1964. Vol. 7. N 4. P. 811—821.
- [2] Птащенко А. А. // ЖПС. 1980. Т. 33. № 5. С. 781—803.
- [3] Ueda O., Imai H., Fujiwara T. et al. // J. Appl. Phys. 1980. Vol. 51. N 10. P. 5316—5325.
- [4] Hayashi I. // J. Phys. Soc. Jap. Suppl. A. 1980. Vol. 49. N 1. P. 57—60.
- [5] Козан Л. М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды. М.: Энергоатомиздат, 1983. 208 с.
- [6] Торчинская Т. В., Брайловский Е. Ю., Семенова Г. Н. и др. // ФТП. 1984. Т. 18. Вып. 8. С. 1379—1402.
- [7] Торчинская Т. В., Абдуллаев Ж. С. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 7. С. 175—178.
- [8] Тхорик Ю. А., Хазан Л. С. Пластическая деформация и дислокации несоответствия в гетерозитаксиальных системах. Киев: Наукова думка, 1983. 304 с.
- [9] Торчинская Т. В., Семенова Г. Н., Шейнкман М. К. // УФЖ. 1989. Т. 34. № 8. Р. 1079—1084.
- [10] Godwod K., Nagy A. T., Rek Z. // Phys. St. Sol. (a). 1976. Vol. 34. N 2. P. 605—710.
- [11] Torchinskaya T. V., Shtatov A. A., Sheinkman M. K. // Phys. St. Sol. 1988. Vol. 110. N 1. P. 213—220.
- [12] Jordan A. S., Ralston J. M. // J. Appl. Phys. 1976. Vol. 47. N 10. P. 4518—4527.
- [13] Longini R. L. // Sol. St. Electron. 1962. Vol. 5. N 1. P. 127—135.
- [14] Болтакс Б. И. Диффузия в полупроводниках. М.: Физ.-мат. лит., 1961. 462 с.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Поступило в Редакцию
1 ноября 1989 г.